

News Release

For Immediate Release

May 1, 2017

Contacts:

Roger Dullinger, Marketing Communications Manager
(952) 469-8278, Roger.Dullinger@itweae.com

Vitronics Soltec 的产品荣获回流焊和选择性焊类别的2项中国远见奖

Oosterhout, 荷兰 · 2017年5月1日 - ITW EAE 的 Vitronics Soltec 非常高兴在 Nepcon 上海展会上荣获 2 项令人垂涎的中国远见优秀奖 (VA Excellent Awards)。 CATHOX™ 热氧催化系统获得回流焊类别的优秀奖, ZEVA™ 获得选择焊类别的优秀奖。

热氧催化系统 (CATHOX) 一种能够使SMT回流炉腔保持干净, 避免污染的先进系统。一个基于纳米材料的催化系统应用热化学反应分解从锡膏, 电路板和元件中分挥发出的有机物气体。在 250 度温度条件下, 这种纳米技术能够改变物质化学成分, 这对回流焊工艺中去除挥发性化合物是非常有效的。在热氧化中, 有机气体被转化成碳氢化合物, 被过滤器捕获。

“CATHOX 极大地减少了维护,” ITW EAE 焊接解决方案商务经理 Ton Colijn 说道 “不断增加的产量压力、微型化和使用通孔锡膏印刷回流焊接增加了锡膏的使用量, 这导致回流炉需要更多的维护。创新的 CATHOX 技术延长了正常运行时间10%。”

ZEVA™ 选择性焊接系统特有的专利技术, 出色应对微型化挑战。高频助焊剂滴状喷射技术允许更快的自动运行和更短的循环时间。在经过预热之后, 电路板被送到一个可以 X 或 Y 方向倾斜的独立传送单元。电路板被倾斜并且在波峰上拖曳。倾斜角度可平行或垂直传送带向上/向下 4 到 10 度, 以使焊点各个方向都达到良好的焊接效果。锡炉可以 360 度旋转, 利用旋转与倾斜这两个特性, 可以使得采用非润湿的喷嘴焊接细间距连接器的焊接效果与采用润湿的喷嘴焊接一样。结合焊锡排放调节器的使用, 可以消除细间距连接器上的桥接。

“ZEVA™ 专为客户应对细间距焊接挑战而设计的” 焊接解决方案商务经理 Ton Colijn 说道 “可倾斜的焊接能力被证明有利于细间距组件的焊接, 为突破焊接禁区难点的程序设置提供更大的灵活性。”